

## 举办“JISSO Seminar 2025 in ASEAN”

~向东南亚地区的日系制造企业介绍下一代贴装技术的最新发展动向~

株式会社 FUJI(公司总部:爱知县知立市、代表取缔役社长:五十榎 丈二、以下简称“FUJI”)于2025年12月3日(星期三)~4日(星期四),在Fuji Machine Asia Innovation Center(泰国)举办了“JISSO Seminar 2025 in ASEAN”。



在亚洲地区,随着生产据点不断向多元化的方向发展,以越南和泰国为中心的东南亚国家对设备的需求在持续增加。近年来,随着服务的行业和产品不断朝多样化的方向发展,东南亚地区的制造企业也迫切需要对包括设备、材料以及过程在内的整个生产体系进行转变——变成更为智能、灵活的生产体系。针对该地区特有的课题与需求, FUJI 提出了名为“Target ZERO”的全新愿景。为了实现“零贴装不良”、“零操作员”、“零停机”以及新提出的“零贴装界限”这些目标,在本次研讨会上我们讲解了引进 E2E AI 的电子技术所支持的最新贴装技术以及这些技术为制造现场带来的变革。

另外,本次活动还得到了 Meiko Electronics Co., Ltd.、Meiko Techno Co., Ltd.和株式会社田村制作所(TAMURA Corporation)的协助,举办了以整个贴装工艺流程(覆盖从电路板、锡膏材料、锡膏印刷用钢网到回流焊的方方面面)的行业动向为主题的研讨会。参加研讨会的企业主要是在以泰国为中心的东南亚各国设有据点的日系企业。两天共有 39 家公司、超过 130 人到场,研讨会在热烈的氛围中圆满结束。

每一场研讨会结束后,在 FUJI 及协办企业的展位上都进行了实机演示,并进行了积极的商务洽谈与意见交流。作为与东南亚地区用户进行交流的重要平台,本次活动得到了用户的高度评价,同时也收到了希望 2026 年以后继续举办的反馈。

## “JISSO SEMINAR 2025 in ASEAN” 的概要

- 举办时间：2025 年 12 月 3 日(星期三) ~ 12 月 4 日(星期四)
- 举办地点：Fuji Machine Asia Innovation Center (泰国)

### 主要内容：

- 研讨会 1：“KAIZEN：从制造现场的课题出发采取新的举措” (FUJI)
- 研讨会 2：“制造现场将会怎么变？ E2E AI 和贴装技术的最前沿” (FUJI)
- 研讨会 3：“印刷电路板技术的介绍” (Meiko Electronics)
- 研讨会 4：“钢网的现状与未来” (Meiko Techno)
- 研讨会 5：“AI 服务器、汽车电子、通信行业的贴装课题与对策” (田村制作所)
- 研讨会 6：“实现碳中和” (田村制作所)
- 实机演示 (包含 NXTR 与 sFAB)



## 未来的展望

为了实现包括新的“零贴装界限”在内的“Target ZERO”，FUJI 将加速推进各项举措。通过扎根当地的各类活动，努力打造“FUJI 品牌”并提升公司知名度，以回应用户的信心和期待。今后，FUJI 还将继续通过展会、研讨会和大家分享电子元件贴装领域的最新技术；作为一个值得信赖的技术合作伙伴，力争为制造业的可持续发展作出贡献。